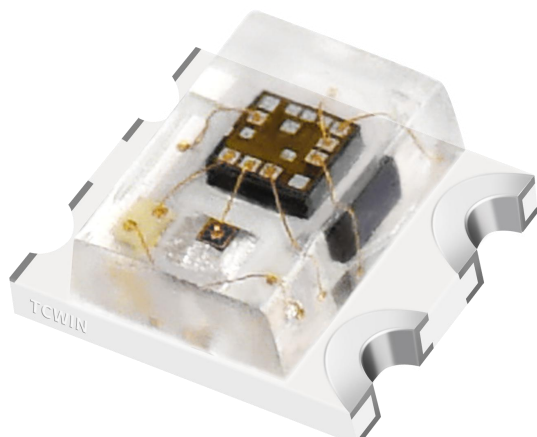


SPECIFICATIONS

产品规格书

客户名称 Customer		产品名称 Product	RGB LED（内置IC）
客户代码 Customer NO.		产品型号 Type	TX1812IWCU-F01



0807 内置 IC 幻彩

智能外控 LED 光源

1.7 x 2.0 x 0.85 mm

小体积 SMD LED 器件

客户审核 Customer Audit			天成高科 TCWIN		
核准	确认	制作	核准	确认	制作
			金国奇	黄奕源	廖桂荣
☐ 接收		☐ 不接收	日期：20230419 版本号：A1		



地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区长凤路 263 号天成高新园

电话：18129969297

邮箱：fengyi@tczmled.com

网址：www.tcwinled.com

邮编：518106



目 录

1、产品概述	3
2、主要应用	3
3、特征说明	3
4、产品尺寸	4
5、产品命名规则	4
6、引脚功能	5
7、RGB 光电特性	5
8、绝对最大值	6
9、IC 电气参数	6
10、开关特性	6
11、数据传输时间	7
12、时序波形图	7
13、数据传输方式	8
14、24bit 数据结构	8
15、典型应用电路	8
16、光电特性曲线	9
17、包装	10
18、可靠性测试	11
19、焊接说明	12
20、注意事项	13

1. 产品描述

TX1812IWCU-F01是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控 LED 光源。其外型与一个0807LED 灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,电源稳压电路,内置恒流电路,高精度 RC 振荡器,输出驱动采用专利 PWM 技术,有效保证了像素点发光颜色一致性。

数据协议采用单极性归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN 端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的 24bit 数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过 DO 端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少 24bit。

LED 具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于 LED 上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。

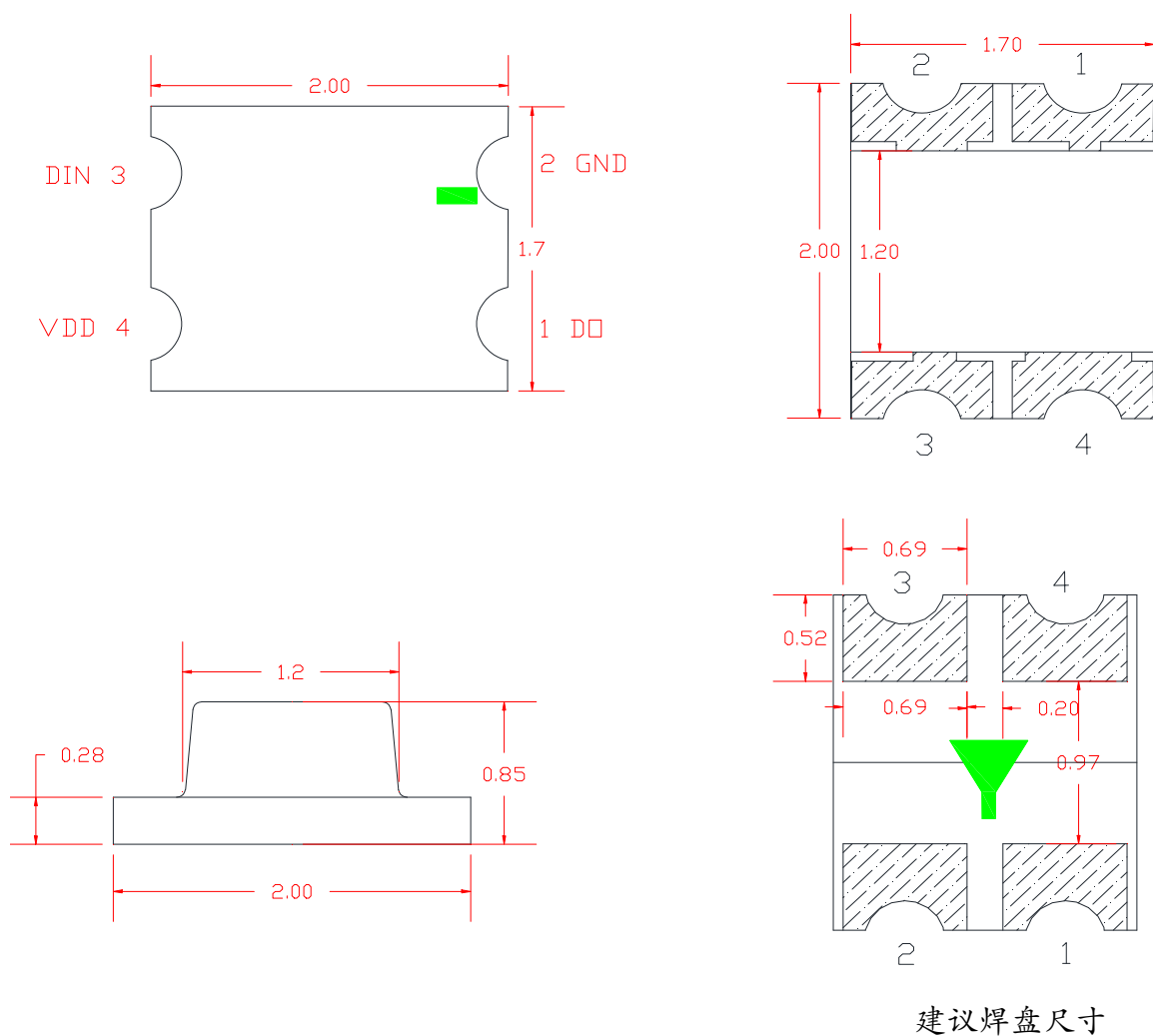
2. 主要应用

- LED 全彩发光字灯串,LED 全彩模组,LED 幻彩软硬灯条,LED 护栏管,LED 景观/情景照明。
- LED 点光源,LED 像素屏,LED 异形屏,机箱风扇氛围灯,各种电子产品,电器设备跑马灯。

3. 特征说明

- LED 内部集成高质量外控单线串行级联恒流 IC;
- 控制电路与芯片集成在 SMD 0807 元器件中,构成一个完整的外控像素点,效果均匀且一致性高;
- 内置数据整形电路,任何像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加;
- 内置上电复位和掉电复位电路,默认上电不亮灯;
- 灰度调节电路(256 级灰度可调);
- 红光驱动特殊处理,配色更均衡;
- 数据串行级联传输,抗干扰能力强;
- 整形转发强化技术,两点间传输距离超过 10M;
- 数据传输频率可达 800Kbps, 当刷新速率 30 帧/秒时,级联数不小于 1024 点。

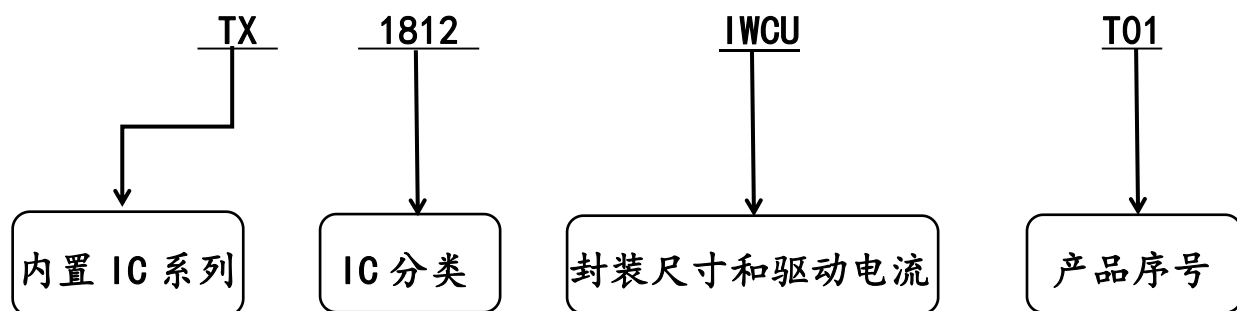
4. 产品尺寸



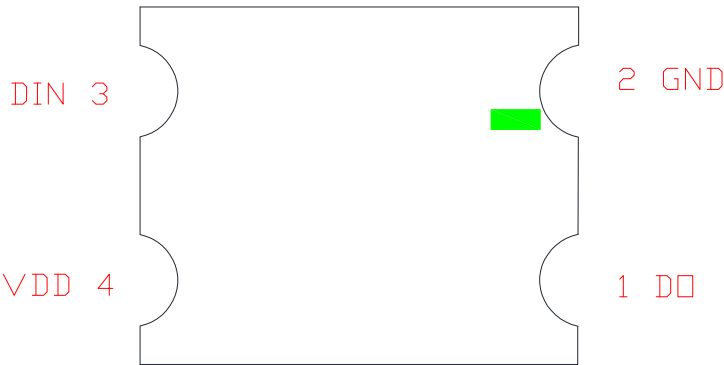
注:

- 所有标注尺寸的单位均为 mm;
- 除了特别注明, 所有标注尺寸的公差均为 $\pm 0.05\text{mm}$;
- 封装尺寸: $1.7 \times 2.0 \times 0.85\text{mm}$;

5. 产品命名规则



6. 引脚功能



序号	符号	管脚名	功能描述
1	DO	数据输出	控制数据信号输出
2	GND	地	信号接地和电源接地
3	DIN	数据输入	控制数据信号输入
4	VDD	电源	供电管脚

7. RGB 光电特性

项目	符号		最小	平均	最大	单位	测试条件
主波长	λ_d	G	520		525	nm	IF=11.5mA
		R	620		625		
		B	465		470		
发光强度	IV	G	800		1200	mcd	IF=11.5mA
		R	200		400		
		B	150		300		

8. 绝对最大额定值

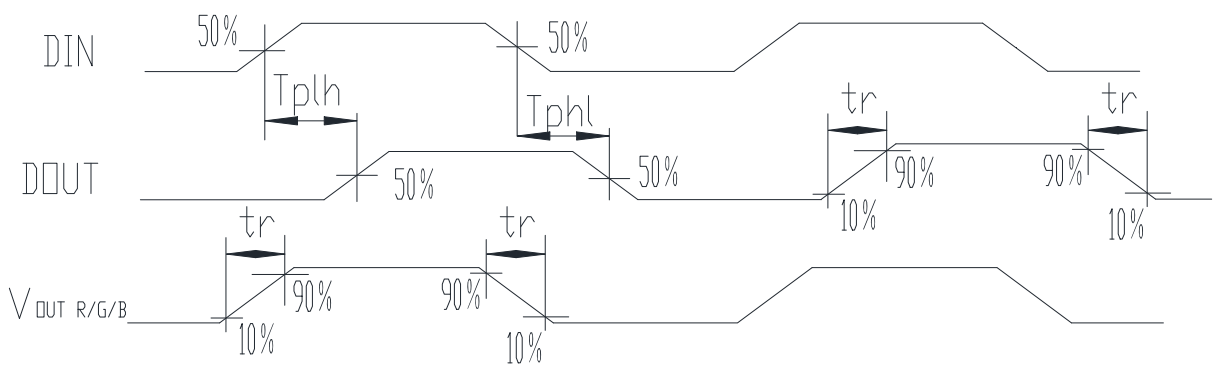
参数	符号	范围	单位
逻辑电源电压	V _{DD}	3.5~5.5	V
逻辑输入电压	V _I	-0.5~5.5	V
工作温度	T _{opt}	-40~85	°C
储存温度	T _{stg}	-55~150	°C
ESD耐压	V _{ESD}	2K	V

9. IC 电气参数

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
R/G/B输出端口耐压	V _{ds}	--	--	10	V	--
R/G/B输出驱动电流	I _o	--	11.5	--	mA	--
高电平输入电压	V _{IH}	3.1	--	--	V	--
低电平输入电压	V _{IL}	--	--	1.5	V	--
D0输出电流	I _{OH}	--	-14	--	mA	--
D0灌电流	I _{OL}	--	14	--	mA	--
PWM频率	F _{PWM}	--	4.5	--	KHZ	--
静态功耗	I _{DD}	--	0.45	--	mA	--

10. 开关特性

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
数据传输速率	F _{DIN}	--	800	--	KHZ	--
传输延迟时间	T _{PLZ}	--	80	--	ns	DIN→D0
输出电流转换时间	T _r	--	500	--	ns	V _{ds} =1.5V I _o =11.5mA
	T _f	--	500	--	ns	



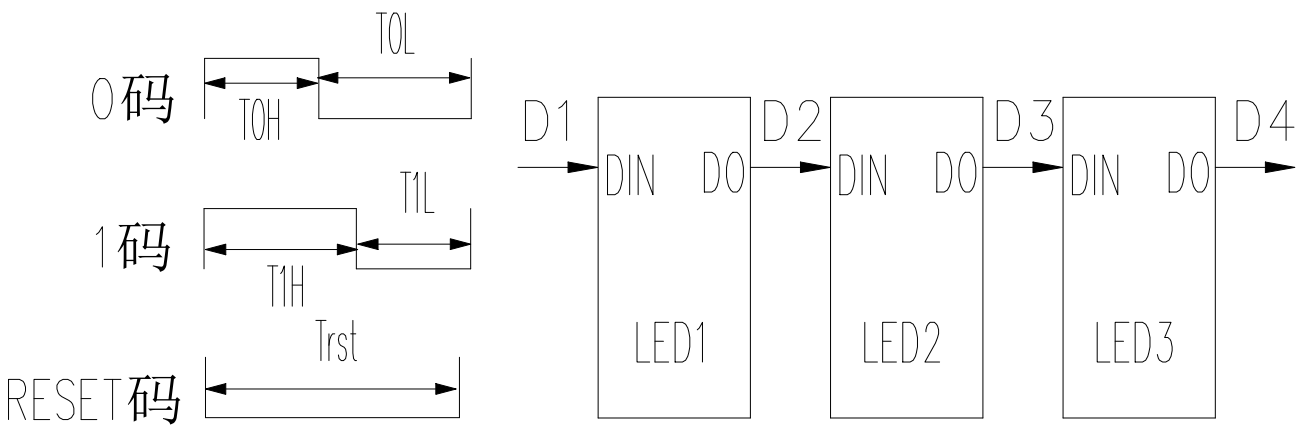
11. 数据传输时间

T符号	码元	典型值	误差
T0H	0码，高电平时间	0.3us	±0.05us
T0L	0码，低电平时间	0.9us	±0.05us
T1H	1码，高电平时间	0.9us	±0.05us
T1L	1码，低电平时间	0.3us	±0.05us
Trst	Reset码，低电平时间	≥200μs	--

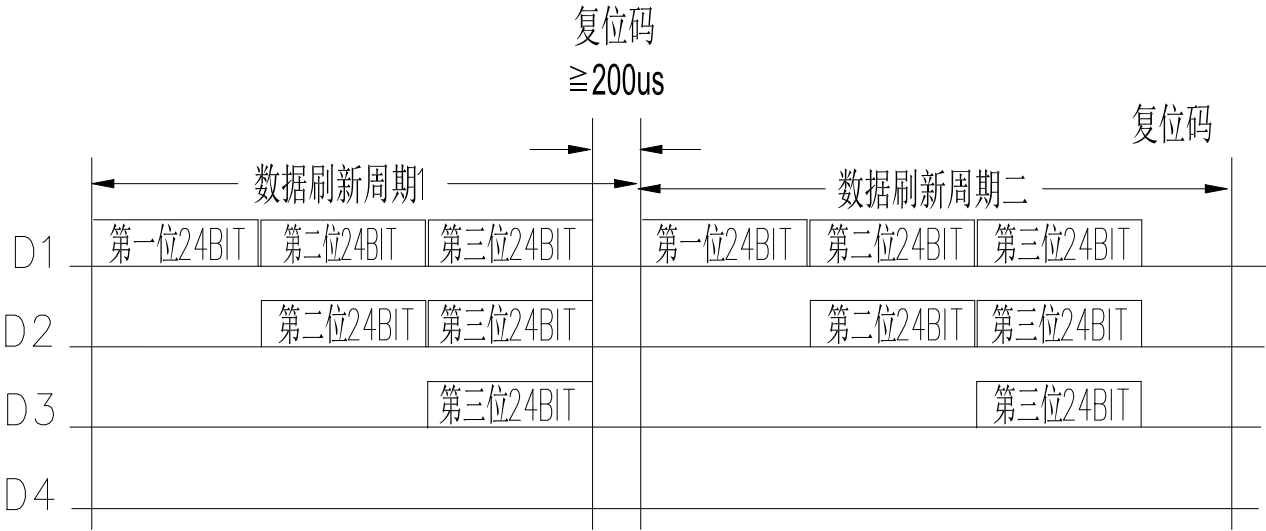
12. 时序波形图

输入码型：

连接方式：



13. 数据传输方式



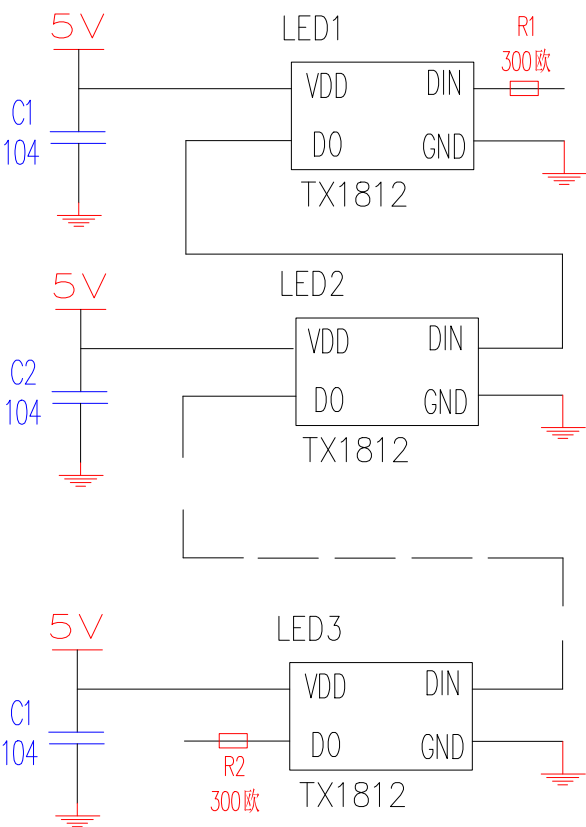
注：其中 D1 为 MCU 端发送的数据，D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据

14. 24bit 数据结构

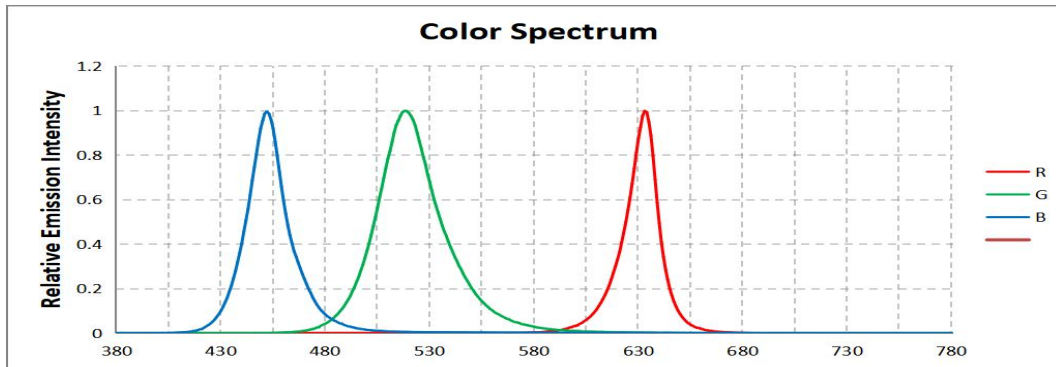
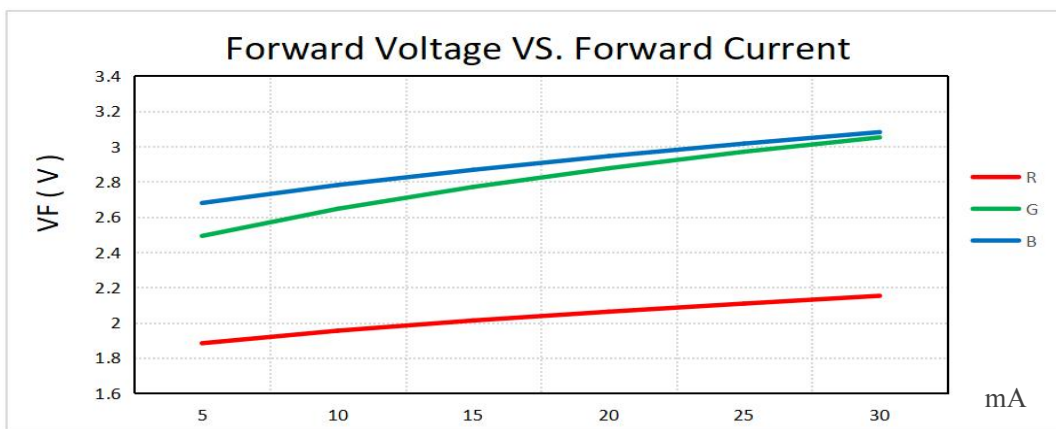
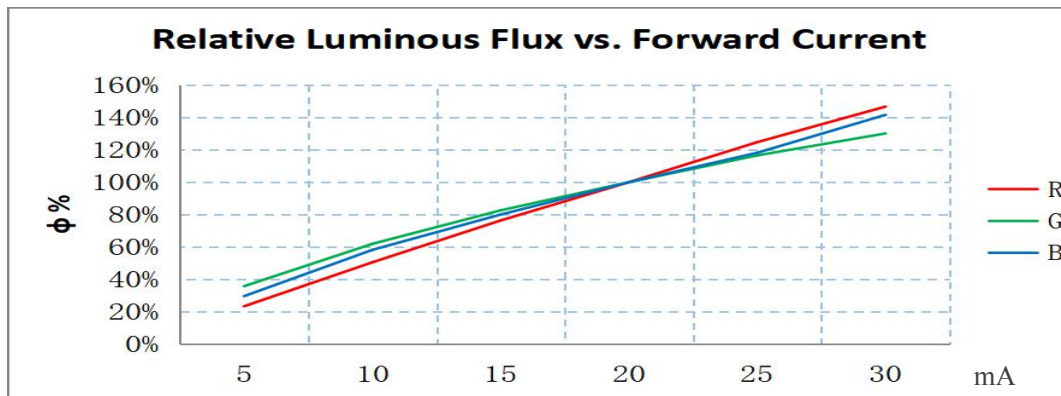
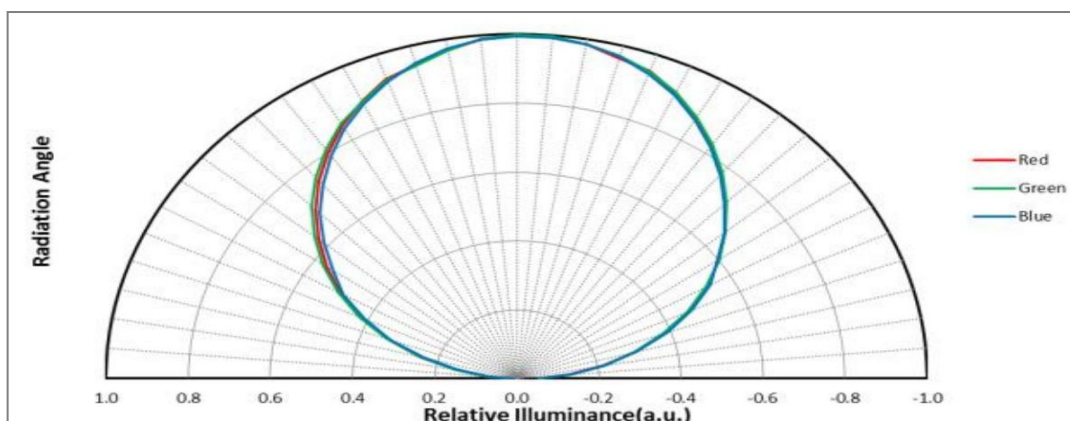


注：高位先发，按照 GRB 的顺序发送数据

15. 典型应用电路

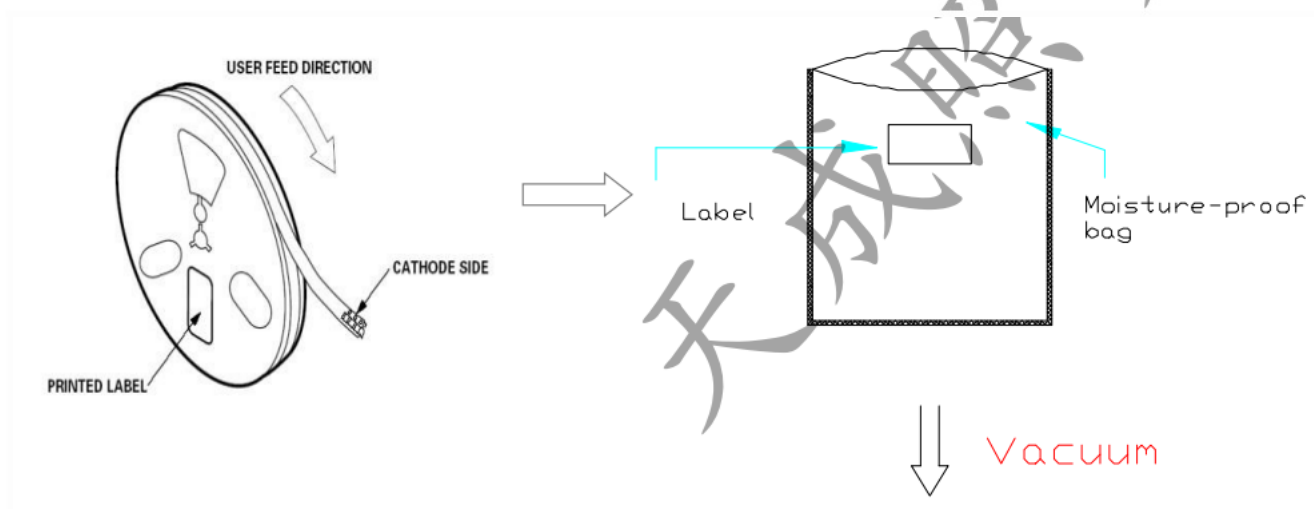
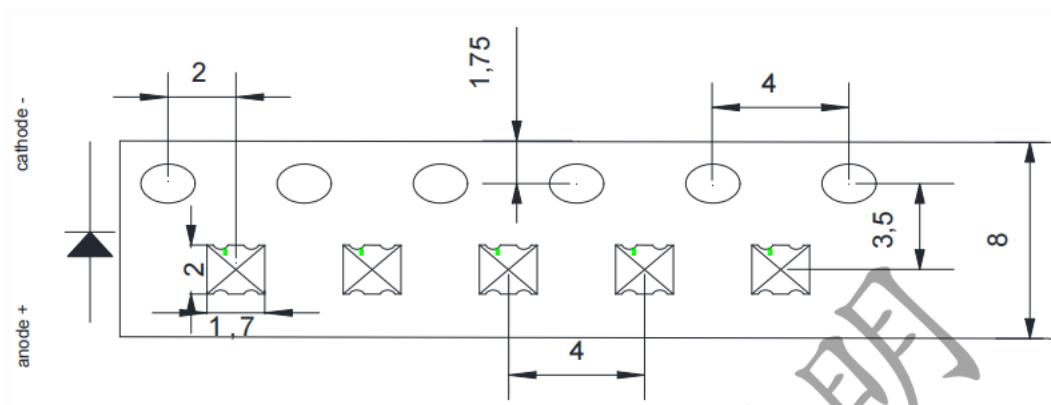


16. 光电特性曲线)

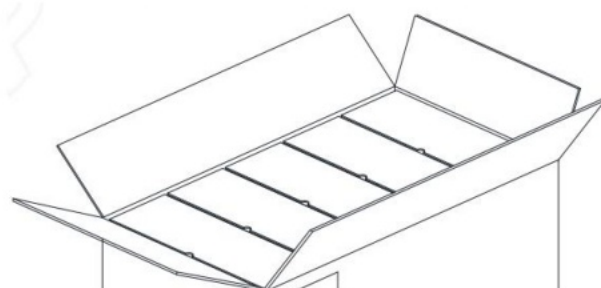
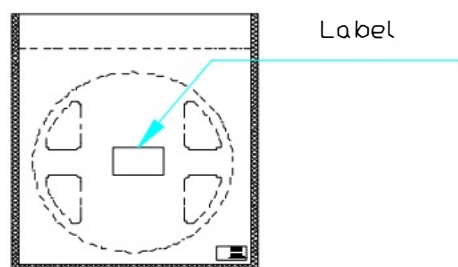
■ 光谱图, $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ■ 电压与电流关系, $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ■ 亮度与电流关系, $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ■ 角度图, $T_a=25^{\circ}\text{C}$, $I_f=11.5\text{mA}$ 

17. 包装规格

● 进料方向



标签图示



● 包装数量

卷盘尺寸：178x12mm，5000pcs/卷；

卷盘尺寸：330x12mm，16000pcs/卷；

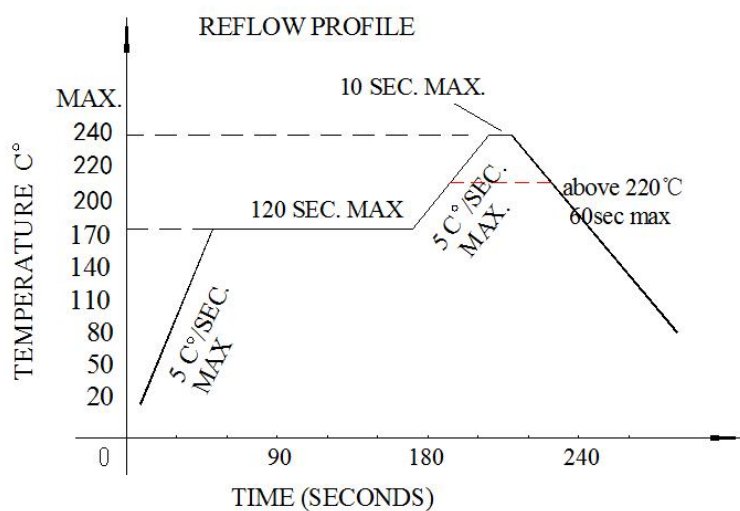
18. 可靠性测试

测试项目和结果

序号	测试项目	参考标准	测试条件	备注	结论
1	回流焊	JESD22-B106	Tsld=240°C, 10sec	3 times	0/22
2	温度循环	JESD22-A104	-20°C 30min ↑ ↓ 15min 120°C 30min	200 cycle	0/22
3	冷热冲击	JESD22-A106	-40°C 15min ↑ ↓ 15sec 125°C 15min	200 cycle	0/22
4	高温存储	JESD22-A103	T _a =100°C	1000 hrs	0/22
5	低温存储	JESD22-A119	T _a =-40°C	1000 hrs	0/22
6	点亮高低温循环	JESD22-A105	On5min-40°C>15min ↑ ↓ ↑ ↓ <15min Off5min100°C>15min	200 cycle	0/22
7	老化测试	JESD22-A108	T _a =25°C I _F =11.5mA	1000 hrs	0/22
8	高温高湿	JESD22-A101	60°C RH=90% I _F =11.5mA	1000 hrs	0/22

19. 焊接说明

■ 回流焊简介



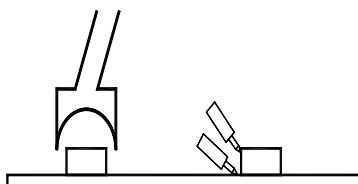
- 回流焊次数不应超过 2 次
- 焊接时，在加热过程中不能有应力作用于 LED 灯珠

■ 烙铁

- 手工焊接时，烙铁温度控制在 300 $^{\circ}\text{C}$ 以下，且时间不可超过 3 秒
- 手工焊接只可焊接一次；

■ 返工

- 温度保持在 240 $^{\circ}\text{C}$ 以下，5 秒内完成返工作业
- 烙铁不能碰触到 LED 灯珠
- 双头形烙铁为最佳



20. 注意事项

➤ 使用注意事项

为确保内置 IC 灯珠产品在 SMT 贴片回流焊和使用过程良率及产品稳定性，经过多次试验验证特制订以下各工序相关注意事项如下：

1、样品评估：因本产品为内置 IC 产品，整体工艺差别于常规 RGB 产品，所以客户端在样品评估时需进行全方位验证，确保产品的匹配性能；

2、来料检验：确保真空包装完好，无漏真空现象，如有漏真空请确认回流焊是否异常，如异常需返厂重新高温除湿；

3、使用事项：正式贴片前请先做好首件确认，使用时按拆一包用一包的原则，灯珠裸露在空气中不得超过 4 小时，贴片完成灯珠需在 2 小时以内过完回流焊，使用锡膏为中低温锡膏，回流焊最高温度不得超过 240 度；

4、维修要求：材料在回流焊后 4 小时内需完成测试和维修灯珠，如超过 4 小时需将要维修灯板低温 65℃除湿 12 小时以上才可进行维修作业，且维修所需的灯珠也要进行低温 65℃除湿 12 小时以上才可使用，维修过程中禁止用温度超过 240℃加热台进行返修，禁止整板放置于加热台上返修，遵循坏哪颗返哪颗的原则。

温馨提示：整个工序特别注意事项为灯珠使用前真空包装、除湿后贴片放置时间和车间的温湿度管控，产品维修时灯板如裸露在室温环境时间过长灯板和灯珠需进行除湿，灯珠为 LED 电子元器件产品，需注意春夏季防潮，秋冬季防静电，产品品质就是一家企业的生命，以质量求生存，以质量求发展是我司的一贯宗旨。也为保证客户端品质，请严格参照以上建议操作。

防潮等级定义

防潮等级验证						
防潮等级	材料拆包后使用寿命		验证条件			
	时间	条件	标准条件		加速条件	
			时间	条件	时间	条件
LEVEL1	无限制	$\leq 30^{\circ}\text{C}/85\%\text{RH}$	168+5/-0H	$85^{\circ}\text{C}/85\%\text{RH}$	/	/
LEVEL2	1 年	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	168+5/-0H	$85^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	/	/
LEVEL2a	4 周	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	696+5/-0H	$30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	120+5/-0H	$60^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$
LEVEL3	168 小时	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	192+5/-0H	$30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	40+5/-0H	$60^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$
LEVEL4	72 小时	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	96+5/-0H	$30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	20+5/-0H	$60^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$
LEVEL5	48 小时	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	72+5/-0H	$30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	15+5/-0H	$60^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$
LEVEL5a	24 小时	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	48+5/-0H	$30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	10+5/-0H	$60^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$
LEVEL6	取出即用	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	取出即用	$30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	/	/

封装的 LED 为硅材料。该 LED 具有软表面的封装顶部。顶部表面的压力会影响 LED 的可靠性。应采取预防措施，以避免有过大的压力作用于在封装件上。因此，在选用吸嘴时，应适用于有机硅树脂的压力。

